

红板科技：打造世界一流电路板生产基地 为电子设备提供最稳定可靠连接

——江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

江西红板科技股份有限公司董事长、总经理
江西红板科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

叶森然先生
文伟峰先生

国联民生证券承销保荐有限公司保荐代表人
国联民生证券承销保荐有限公司保荐代表人

曾文强先生
帖晓东先生

江西红板科技股份有限公司 董事长、总经理叶森然先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好！
欢迎各位参加江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上投资者交流会。我谨代表红板科技，向长期以来关心和支持公司发展的投资者、合作伙伴以及社会各界朋友，表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！

红板科技作为国家高新技术企业，长期深耕高精度、高密度和高可靠性PCB的技术研发与智能制造，积累了多项行业先进技术，提升了整体生产效率和产品质量。在HDI板领域，公司已全面掌握高端HDI板的生产技术，任意层互连HDI板最厚层数可达26层，且整体层厚公差可控制在50μm以内，处于行业领先地位。在IC载板领域，公司掌握了mSAP等工艺，具有Coreless、ETS等叠构技术及超薄芯板制作能力，成功突破IC载板关键技术并实现量产，打破高端精密电路板制造的技术壁垒。

国联民生证券承销保荐有限公司 保荐代表人曾文强先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好！
首先，我谨代表国联民生证券承销保荐有限公司，向所有参与江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

红板科技自成立以来，始终专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，已形成涵盖HDI板、刚性板、柔性板、刚柔结合板、IC载板等在较为完善的产品体系，广泛应用于消费电子、汽车电子、高端显示、通信电子等领域。经

江西红板科技股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书文伟峰先生致结束语



尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好！
江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流活动已接近尾声。在此，我谨代表红板科技，感谢大家对本次发行的密切关注和热情参与。感谢国联民生证券承销保荐有限公司为本次网上交流会顺利举行所付出的努力。同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报及中国证券网为我们提供优秀的沟通交流平台。

通过今天的交流和沟通，我们深切感受

到依靠完善的产品结构、深厚的行业技术实力和良好稳定的产品质量，公司与多家具有全球影响力的行业龙头建立了长期合作关系，覆盖消费电子、汽车电子、高端显示及通信电子等多个重要领域。2024年，公司为全球前十大手机品牌提供HDI主板1.54亿件，市场占有率约为13%；在电池板领域，公司已进入多家头部品牌供应链体系，市场占有率约为20%，在细分市场处于领先地位。

此次登陆资本市场，是红板科技发展历程中的重要里程碑。通过上市募集资金，公司将加快推进精密电路板项目建设，进一步提升高阶HDI制程能力和技术水平。随着产能逐步释放，公司将持续优化产品结构，全面提升规模化与精细化运营能力。

展望未来，随着AI技术的快速发展，算力需求呈现爆发式增长，对高性能PCB产品提出了更高要求。公司将顺应产业发展趋势，坚持以“AI算力、低轨卫星、智能座舱、光模块、智能驾驶”为产品导向的发展战略，推动多应用场景协同发展。我们将通过强化自主创新 and 全球合作，进一步提升核心竞争力和市场份额，将公司建设成为印制电路板行业中高端HDI板的标杆企业。

今天的交流活动为投资者提供了深入了解公司的机会。我们期待通过坦诚、充分的沟通，使大家更加全面地认识红板科技的发展战略与长期价值，并与公司共同分享未来的成长机遇。

再次感谢大家的关注与支持！欢迎各位积极提问。也期待通过本次交流，让大家对红板科技有更加清晰和深入的认识。谢谢大家！

过多年深耕，公司在高阶HDI及相关工艺技术方面持续积累，形成了较强的研发制造能力和良好的客户基础，是国内中高端PCB领域具有较强竞争力的企业之一。

作为红板科技本次发行上市的保荐人和主承销商，国联民生证券承销保荐有限公司在与公司合作过程中，深切感受到公司管理团队稳健务实、战略清晰，对行业发展趋势和客户需求变化具有较强的把握能力。公司坚持以技术创新为驱动，不断优化产品结构、提升工艺水平、拓展优质客户资源，逐步构建起自身在中高端PCB领域的综合竞争优势，也为未来持续发展打下了坚实基础。

我们相信，借助本次公开发行，红板科技将进一步夯实自身在中高端PCB领域的竞争优势，持续提升研发、制造和服务能力，在资本市场实现更高质量的发展。

在今天的网上交流中，我们将认真、负责地回答各位投资者朋友关心的问题，帮助大家更加全面、深入地了解红板科技的业务特点、竞争优势和发展前景。欢迎大家踊跃提问，互动交流。

最后，预祝红板科技本次网上路演圆满成功！谢谢大家！

到广大投资者对红板科技的关注和期待。相信大家对红板科技的行业前景、竞争优势、公司治理、募投项目及发展战略等都有了更加全面的认识和了解。非常感谢各位提出的问题和建议。

同时，我们也深刻地意识到作为一家公众公司的使命、责任和压力。我们将不断提升产品质量和精细化管理水平，提高公司核心竞争力，借助资本市场平台，以创新引领印制电路板行业技术发展。红板科技全体员工将以更加专业、求是的精神，以更加优异的成绩回报广大投资者的支持与信任！

红板科技此次登陆资本市场，是公司发展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信，在各方的帮助和支持下，红板科技将牢牢抓住资本市场赋予的发展契机，努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司。我真诚地希望，大家继续通过电话、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

最后，再次感谢社会各界朋友对红板科技的关注和支持！我们期待与广大投资者一起共创美好未来。谢谢大家！



经营篇

问：公司的业务是什么？

曾文强：公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，是行业内HDI板收入占比较高、能够批量生产任意互连HDI板和IC载板的企业之一。

公司已形成完善的产品结构，包括HDI板、刚性板、柔性板、刚柔结合板、类载板、IC载板等，并具备全面的技术研发和生产能力，可为客户提供多样化的产品选择和一站式服务。

问：公司产品在通信电子领域有何应用？

文伟峰：公司聚焦通信模组、开发套件等PCB产品的制造，加大服务器、光模块等领域的研发。通信电子涵盖通信终端与通信设备领域，其中通信设备包括路由器、交换机、通信基站等有线或无线网络传输的通信基础设施。随着5G网络建设的大规模推进及商用，全球将迎来新一轮科技革命和产业变革，5G与云计算、大数据、物联网等技术深度融合，将催化通信设备相关技术和应用更快发展、迭代，融合，对通信设备PCB提出更多的技术挑战和要求。公司客户包括知名无线通信模组厂商移远通信、广和通，全球知名EMS工厂富士康。

问：公司产品在计算机领域有何应用？

文伟峰：公司积极拓展计算机领域，不断提升产品科技含量及附加值。计算机为PCB行业的传统领域，其具体应用于台式机、笔记本电脑等。信息时代快速发展带来数据流量的爆发式增长，促进大数据等行业应用，从而带动数据存储及服务器需求增长。公司的计算机及周边设备领域客户包括英特尔、佳能、正文科技、海华科技等多家全球知名企业。

问：公司主要的原材料是什么？重要的供应商有哪些？

曾文强：公司采购的主要原材料包括覆铜板、铜球和铜粉、金盐、半固化片、铜箔等。2022年至2025年，公司主要的供应商包括生益科技、江西新材料科技股份有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司、中山台光电子材料有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司等行业知名企业。

问：公司取得了哪些研发技术成果？

文伟峰：公司始终坚持研发创新导向，构建了完善的自主研发体系。截至2025年12月31日，公司及子公司共拥有专利399项，其中发明专利34项、实用新型专利365项。公司承担了《多层高密度印制电路板绿色关键工艺突破》国家级技术项目，实现了PCB生产工艺的绿色化突破。《面向智能移动通讯设备的HDI电路板制造关键技术及产业化》项目获得江西省科学技术进步三等奖，《面向新能源汽车动力控制系统的高密度电路板研发及产业化》项目获得中国电子元件行业协会科技进步奖二等奖。

问：请介绍公司的研发创新平台。

文伟峰：公司是国家高新技术企业，十分重视研发平台建设，设立了研发中心，配备了先进的研发设备和专业的研发队伍，以技术发展趋势和客户需求为导向，积极进行新技术、新产品和新材料的研究开发，具备较强的研发能力。

问：公司的生产及销售能力如何？

文伟峰：报告期内（2023年至2025年，下同），公司PCB产品的产量分别为152.93万平方米、179.76万平方米和207.10万平方米，产能利用率分别为85.01%、88.51%和88.57%。

问：公司的营业收入是多少？

帖晓东：报告期内，公司营业收入分别为233953.41万元、270247.82万元和367701.62万元，整体呈增长态势。

问：公司的净利润是多少？

帖晓东：报告期内，公司净利润分别为10492.60万元、21391.41万元和53984.85万元，盈利能力及财务状况良好。

问：公司的主营业务毛利率是多少？

帖晓东：报告期内，公司主营业务毛利率分别为11.04%、13.98%和12.79%。

问：公司的研发投入是多少？

帖晓东：报告期内，公司研发费用分别为

10971.88万元、12519.81万元和14688.11万元，呈逐年增长趋势。2023年至2025年，公司累计研发费用为38179.80万元，占当期累计营业收入的比例为4.38%。最近三年，公司研发费用复合增长率为15.70%。

发展篇

问：公司的战略规划有哪些？

叶森然：公司秉持“持续改善，全面创新，以人为本，共创价值”理念，以“为电子设备提供最稳定可靠的连接”为使命，致力于打造世界一流电路板生产基地。面对AI、智能驾驶等发展带来的机遇，公司将深化技术布局，以“AI算力、低轨卫星、智能座舱、光模块、智能驾驶”为导向，巩固提升研发能力，推动多终端业务协同，强化创新与合作，提高核心竞争力和占有率，成为印制电路板行业中高端HDI板标杆企业。

问：公司为实现战略目标已采取哪些措施？

叶森然：报告期内，为实现战略目标，公司从以下几个方面着手：1）坚持研发创新，优化现有产品技术水平；2）不断完善产品结构，积极布局IC载板产品；3）加大市场拓展力度，优化客户结构；4）重视内部人才培养和外部人才引进，实施股权激励。

问：为达成战略规划目标，公司将采取哪些具体举措？

叶森然：公司将采取的具体举措：1）提升工艺技术水平，逐步实现IC载板量产；2）开拓细分市场，升级创新产品结构；3）以客户需求为导向，拓展国内外优质客户；4）自动化升级改造，加强精细化管理和智能化生产。

问：请介绍公司的技术储备与创新安排。

文伟峰：公司自设立以来积极推进印制电路板产品、技术、工艺的研发创新，通过理论与实务结合，以市场需求和市场发展为导向，合理筛选研发项目，设立明确的研究目标，制定详细的研究计划，不断进行关键核心技术的突破和产品创新。同时，公司积极开展技术合作和行业交流，与井冈山大学化学化工学院签订《战略合作框架协议》，与南昌大学先进制造学院签订《联合培养博士后研究人员三方协议书》，共同攻克与印制电路板有关的技术难题，进一步加强公司研发实力和技术水平，建立长期的人才培养与输送机制。

问：公司积累了哪些生产工艺技术？

文伟峰：公司专注于HDI板、刚性电路板、柔性电路板、刚柔结合板、类载板、IC载板的研发和工艺优化改进，在生产过程中不断收集、总结不足之处，持续提升、完善生产工艺技术能力，满足终端市场对PCB产品“高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化”的要求，积累了高阶HDI电路板制造技术、基于高端封装的Interposer板制造技术、高传输速率光模块电路板制造技术等多项生产工艺技术。

问：公司的重要客户有哪些？

曾文强：公司依靠完善的产品结构、深厚的行业技术实力、良好稳定的产品质量、快速的响应服务能力和创新的管理系统，获得了众多客户的认可并建立了良好稳定的合作关系。公司已积累了一批优质的客户资源，主要包括OPPO、vivo、荣耀、传音、摩托罗拉、森海塞尔、歌尔股份、华勤技术、闻泰科技、龙旗科技、东莞新能德、欣旺达、德赛电池、伟创力、比亚迪、兆驰股份、洲明科技、英特尔、移远通信、广和通、富士康等行业知名企业，优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。

行业篇

问：公司所处哪个行业？

曾文强：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。

问：印制电路板行业的发展前景如何？

叶森然：未来，在低碳化、智能化等因素驱动下，5G通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等PCB下游应用行业预期将蓬勃发展，从而带动PCB需求持续增长。根据Prismark的预测，2024年至2029年，全球PCB产值预计年复合增长

率达5.2%，至2029年将达到946.61亿美元；中国PCB行业产值预计年复合增长率为3.8%，至2029年将达到497.04亿美元。

问：公司所处的PCB行业发展态势如何？

叶森然：印制电路板作为电子产品的重要组成部分，其技术发展趋势与下游应用电子终端产品的需求息息相关。随着5G通信等技术快速兴起，下游电子产品朝着小型化、轻量化、多功能化和信号传输高频化方向发展，促进PCB行业向高密度化、柔性化、高集成化、自动化、环保化等方向发展。

问：公司所在行业的市场竞争情况如何？

曾文强：全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。公司以消费电子和汽车电子PCB为主，主要竞争对手包括华通电脑、景旺电子、宏圣科技、崇达技术、方正科技、博敏电子、中京电子、鹏鼎控股等，上述企业具备较强的资金及研发实力。

问：公司的竞争地位如何？

曾文强：公司已形成完善的产品结构，具备各类别电路板产品较强的生产与研发能力。公司在手机HDI主板和手机锂电池研发和制造领域具有丰富的行业经验，公司2024年为全球前十大手机品牌提供手机HDI主板1.54亿件，柔性电池板和刚柔结合电池板2.28亿件。据测算，公司手机HDI主板供货量约占全球前十大手机品牌出货量的13%，公司柔性电池板和刚柔结合电池板供货量约占全球前十大手机品牌出货量的20%。在中国电子电路行业协会（CPCA）发布的第24届（2024）中国PCB行业综合百强企业排行榜中，公司位于第35位；在Prismark发布的2024年全球前100名PCB企业排行榜中，公司位于第58位。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东及实际控制人情况。

曾文强：截至2025年末，公司控股股东为香港红板，持有公司95.12%的股份。公司实际控制人叶森然通过持有Same Time BVI 100%股权，间接持有香港红板100%股权，进而控制公司95.12%的股份。

问：公司本次发行多少股？

曾文强：公司本次发行的股票数量为10000万股，占本次发行后公司股份总数的13.27%；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份。

问：公司本次募集资金投资项目是什么？

曾文强：公司本次募集资金投资项目为“年产120万平方米高精密度电路板项目”。该项目投资总额为219238.14万元，其中募集资金投资额为205687.74万元。该项目已取得《江西省企业投资项目备案凭证》及相关环评文件，手续完备、合规合法。

问：本次募投项目的必要性有哪些？

曾文强：本次募投项目的必要性体现在：1）扩大产能规模，满足业务发展需求；2）优化产品结构，实现发展战略目标；3）提升智能化制造水平，提高盈利水平；4）顺应行业技术发展趋势，提高市场竞争力。

问：本次募投项目的可行性有哪些？

曾文强：本次募投项目的可行性体现在：1）国家产业政策大力支持PCB行业发展，为项目实施提供了良好的发展环境；2）PCB行业景气度持续上行，为项目实施提供了市场基础；3）优质的客户资源和良好的业务储备，为项目产能消化提供了重要保障；4）专业的研发团队和较强的技术实力，为项目实施提供了技术保障。

问：公司针对中小投资者有何特别保护措施？

叶森然：公司针对中小投资者的特别保护措施包括：1）在股东会表决时，对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票并披露表决结果；2）独立董事将重点关注中小投资者的合法权益，对关联交易、利润分配等事项发表独立意见；3）完善信息披露机制，确保中小投资者能够及时、平等地获取公司信息；4）建立便捷的投资者维权渠道，配合监管机构做好投资者保护工作，保障中小投资者的申诉权和求偿权。